

ADDITIVE FERTIGUNG – WIE GEHT DIE REISE WEITER?

TECHNOLOGIEFORUM MIT AUSSTELLUNG UND FACHPODIUM

Die Verfahren der Additiven Fertigung sind in der industriellen Produktion angekommen. Das Technologieforum des Messeverbunds stellt unter dem Motto ‚Additive Fertigung – wie geht die Reise weiter?‘ Anwendungen aus den unterschiedlichen Einsatzbereichen vor. Die industrieorientierte Forschung korrespondiert dabei mit weitgespannten Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis. Das Technologieforum zeigt an ausgestellten Exponaten beteiligter Unternehmen und in einem stringent ausgerichteten Fachpodium, dass die Reise gerade erst begonnen hat.

AUSSTELLUNG: Als untrennbarer Bestandteil von Intec und Z bietet das Technologieforum jedem Aussteller einen eigenen Infopoint und Platz für seine Exponate und Darstellungen. Jede Fläche verfügt über eine beschriftete Stele mit Basismöblierung und kann zusätzlich mit Mietmöbeln individuell gestaltet werden.



FACHPODIUM: Das Fachpodium ist in die Ausstellungsfläche des Technologieforums integriert. Es bietet an allen Messtagen interessante Vorträge und Diskussionsrunden, aber auch beste Möglichkeiten zum Netzwerken.



KONDITIONEN ZUR BETEILIGUNG AN DER AUSSTELLUNG:

Teilnahmepaket für Aussteller Intec / Z 2025 _____ **450,- €** (zzgl. gesetzl. USt.)

Leistungen: Präsentationsfläche mit Counter, 1 Prospektständer, beschriftbare Stele, 1 Barhocker, 1 Podest, 1 Ausstellerausweis

Teilnahmepaket für Nicht-Aussteller Intec / Z 2025 _____ **1.200,- €** (zzgl. gesetzl. USt.)

Leistungen: Präsentationsfläche mit Counter, 1 Prospektständer, beschriftbare Stele, 1 Barhocker, 1 Podest, 1 Ausstellerausweis, Medienpauschale (Pflichteintrag in der Ausstellerdatenbank Intec / Z 2025 | online mit Firmierung, Anschrift, 1 Eintrag in der Warengruppe „Technologieforum“)

Das Technologieforum wird im Rahmen der breit aufgestellten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Messeverbundes im In- und Ausland aktiv beworben: z. B. bei umfangreichen Fachbesuchermailings im In- und Ausland und in Pressemitteilungen und News.

CALL FOR PRESENTATION:

Als Aussteller des Technologieforums können Sie einen eigenen Fachbeitrag (ca. 20 min.) zu den Themen der Sessions einreichen. Die Vorträge werden von den Mitgliedern des Programmbeirates kuratiert und in den Programmablauf thematisch integriert.

Das Programm steht ab Oktober 2024 auf den Websites zur Verfügung und wird regelmäßig aktualisiert.

Ihr Kontakt: Die Leipziger Messe GmbH ist Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen in Vorbereitung und Durchführung des Technologieforums.



Leipziger Messe GmbH | Messe-Allee 1 | 04356 Leipzig
Annegret Jerke, a.jerke@leipziger-messe.de, Tel.: +49 341 678-8334
www.messe-intec.de | www.zuliefermesse.de

SESSIONS:

- **Material und Prozess**
- **Digitalisierung**
- **Bauteilfertigung**
- **Ersatzteil- / Bauteilbeschaffung**
- **Design Freedom**

PROGRAMMBEIRAT

Prof. Dr.-Ing. Frank Brückner

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS

Dr. Ines Dani,

Building 3D e. V.

Dr. Ronny Grunert

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Dr. Thomas Heber

Composites United e. V.

Alexander Hoffmann

Building 3D e. V.

Dr. Heike Illing-Günther

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V.

Dr.-Ing. Alexander König

BMW AG Werk Leipzig

Dr.-Ing. Elena Lopez

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS + AGENT-3D

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz

Fraunhofer-Kunststoffzentrum Oberlausitz

Christian Vogel

TU Dresden, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik ILK

Prof. Dr.-Ing. Thomas Weißgärber

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM Dresden

Marcus Witt

metrom Mechatronische Maschinen GmbH

Dr. Chongliang Zhong

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM Dresden